

KLA 推出新型 IC 量測系統

實現高性能邏輯和記憶晶片製造

加利福尼亞州米爾皮塔斯市，2020 年 2 月 24 日/美通社/-今天，[KLA 公司](#)（納斯達克股票代碼：KLAC）宣布推出採用圖像技術的 Archer™ 750 疊對量測系統和針對積體電路（“IC”或“晶片”）製造的 SpectraShape™ 11k 光學關鍵尺寸（“CD”）量測系統。在構建晶片中的每一層時，Archer 750 有助於驗證圖案特徵是否與先前層上的特徵正確對準，而 SpectraShape 11k 則監控三維結構的形狀，例如晶體管(transistors)與存儲單元(memory cells)，以確保它們符合規格。通過識別圖案對準或特徵形狀的細微變化，這些新型量測系統可幫助 IC 製造商嚴格控制將高性能記憶體和邏輯晶片推向市場所需的複雜製程，適用於 5G、AI、資料中心和邊際計算(edge computing)。

“隨著 IC 製造商將新穎的結構和新材料集成到了先進的晶片中，他們面臨著以原子尺寸級別的製程誤差，” KLA 量測部門資深副總裁兼總經理 Jon Madsen 表示，“KLA 在確保可以高質量標準的情況下，為這些晶片的成本效益與高品質製造方面發揮了關鍵作用。今天，我很自豪地宣布我們的量測解決方案產品組合中的兩位新成員，它們代表了一支由工程師和科學家組成的一流的、多學科團隊的辛勤工作和創造性思維。新的 SpectraShape 11k 和 Archer 750 系統為我們的晶圓廠客戶帶來了急需的製程控制功能，協助他們生產創新的電子產品，從而推動我們的世界前進。”

存在製程變化的情況下，**Archer 750 疊對量測系統** 可生成準確而可靠的疊對誤差測量結果，同時實現以前僅採用散射測量技術的疊對系統才擁有的產量水平。這一突破性的系統可針對各個製程層提供準確、快速的反饋，從而幫助微影工程師在線識別製程偏差並改善整體圖案的完整性，從而加快良率提升，並更穩定地生產高級邏輯、DRAM 和 3D NAND 器件。

SpectraShape 11k CD 和尺寸形狀量測系統 將靈敏度和生產率空前地結合在一起，可對以前無法實現的材料、結構和晶片形狀進行測量。SpectraShape 11k 具有以高精度和高速度測量高級邏輯、DRAM 和 3D NAND 器件功能的能力，可快速識別製程問題並在生產過程中進行嚴格的製程監控。

有關這些新量測系統，和其中為提供性能而採用的技術進步的更多信息，請參見[產品組合](#)信息頁面。

許多 Archer 750 和 SpectraShape 11k 系統均已通過驗證，並已在全球領先的 IC 製造廠中投入運行，為生產创新型電子器件的許多製程步驟提供關鍵反饋。Archer 750 和 SpectraShape 11k 與 KLA 的 5D Analyzer® 高級資料分析系統集成，可以支持即時製程控制以及工程監控和分析。為了維持晶片製造商所要求的高性能和生產率，Archer 750 和 SpectraShape 11k 量測系統由 KLA 全球綜合服務網絡提供服務。

關於 KLA：

KLA 公司致力於開發領先業界的設備與服務，以及整個電子行業的創新。我們為晶圓和光罩製造、積體電路、封裝、印刷電路板和平面顯示提供先進的製程控制和製程支持解決方案。與全球領先的客戶密切合作，我們的物理學家、工程師、資訊工程師和問題解決專員組成專家團隊，共同設計推動世界前進的解決方案。更多相關信息，請訪問公司網站 www.kla.com (KLAC-P)。

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 Archer 750 和 SpectraShape 11k 系統的預期性能以及量測測量為晶圓、設備、材料和晶片製造設施所帶來的經濟影響都是前瞻性陳述，並且並符合《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中“安全港”(Safe Harbor)條款的規定。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，並且受到諸多風險與不確定性影響。由於各種實際因素，例如(由於成本、性能抑或其他原因造成的)新技術推遲、其他公司推出競爭性產品、或影響 KLA 產品的實施、性能或使用的意外技術挑戰或限制等影響，實際結果可能與此類聲明中的預計結果大不相同。

投資者關係：Kevin Kessel，CFA，投資者關係副總裁，(408) 875-6627，

kevin.kessel@kla.com；媒體關係：Randi Polanich，首席傳播官 (408) 875-6633，
randi.polanich@kla.com